

電路板製作資料清單

請購連絡人: <u>吳昆達</u> 部門: <u>M000</u> 電話: <u>03-5912129</u> 傳真: _____	日期: <u>115</u> 年 <u>6</u> 月 <u>1</u> 日	請購單編號: <u>A562001439</u>
--	--	--------------------------

製作規格:

- 1.板號: AIR_PCB_V0
- 2.層數: 4 Layer
- 3.電路板尺寸: 76.45 MM X 55 MM (單片尺寸----- 0片併板)
- 4.銅箔厚度: 0.5 盎司 / 平方呎 (外層:0.3~0.5 oz 內層: 0.5 oz) 依疊構計算為主
- 5.電路板厚度: 1.5MM ± 0.1 MM 疊構參考下圖
- 6.板材: FR-4 BT PI FR-4補強
- 7.表面處理: 噴錫, 鍍金, OSP(Entek) 鍍銀
- 8.數量: 20 PCS
- 9.預訂完成日期: 115 年 月 日.
- 10.表面防焊 琥珀 透明 綠 黑

交付資料:

- Gerber File, 檔名 : AIR_PCB_V0-20260526(G).zip
- Master Drawing主圖, 參考 _____ 內之檔案

製作完成後,請歸還所有資料

備註:

1. O/S TEST : YES , 單面 雙面
- 2.金手指: NO
- 3.鍍金厚度: YES
- 4.阻抗控制: YES, 10mil 50ohm
- 5.AOI 測試: YES
6. BGA Substrate 特殊製程: NO
7. V-VUT: NO
8. 併板: NO
9. 排連片加版邊: YES
10. 盲埋孔: NO , 1階 2階

收件廠商: _____ 簽收人: _____ 日期: _____

(請收件廠商簽收後傳回連絡人處!)

1. 本表單以板號作為資料之識別。
2. 本所所提供之技術資料,屬於本所之智慧財產權,僅限貴公司承製本案使用,用畢後應歸還本所,貴公司非經本所之書面許可,不得任意複製、使用、轉移、作為其他用途或移轉給第三者。
- 3.